

证券代码：688432
042

证券简称：有研硅

公告编号：2026-

有研半导体硅材料股份公司 关于暂不召开股东会审议本次公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德州汇达基金”）购买山东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称“山东有研艾斯”）合计71.89%的股权；公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司（以下简称“德州景泰”）购买山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）14.98%的股权。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

2026年9月11日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，因此决定暂不召集股东会审议本次交易相关议案。待相关审计、评估等工作完成后，董事会将再次召开会议，审议本次交易的相关事项并发布股东会通知，提请股东会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年9月12日